

EU RoHS 指令 附属書 III 除外の状況の整理

出典 <http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=214>

2016.6.27

適用除外項目			
	1	Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not exceeding (per burner):	電球 (コンパクト形) 蛍光ランプ中の、以下の値を超えない水銀 (1 バーナーにつき)
Pack9	1(a)	For general lighting purposes < 30 W: 5 mg	30W 未満の一般照明用途 : 5mg
Pack9	1(b)	For general lighting purposes \geq 30 W and < 50 W: 5 mg	30W 以上 50W 未満の一般照明用途 : 5mg
Pack9	1(c)	For general lighting purposes \geq 50 W and < 150 W: 5 mg	50W 以上 150W 未満の一般照明用途 : 5mg
Pack9	1(d)	For general lighting purposes \geq 150 W: 15 mg	150W 以上の一般照明用途 : 15mg
Pack9	1(e)	For general lighting purposes with circular or square structural shape and tube diameter \leq 17 mm	円形または四角形の形状の一般照明用途で、管径が 17mm 以下のもの
Pack9	1(f)	For special purposes: 5 mg	特殊用途 : 5mg
2017.12.31	1(g)	For general lighting purposes < 30 W with a lifetime equal or above 20 000 h: 3,5 mg	30W 以下一般照明で寿命が 20,000 以上 : 3.5mg
	2(a)	Mercury in double-capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes not exceeding (per lamp):	一般照明用途の直管型蛍光ランプ中の、以下の値を超えない水銀 (1 ランプにつき)
Pack9	2(a)(1)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter < 9 mm (e.g. T2): 5 mg	通常寿命の tri-band phosphor で、管径が 9mm 未満のもの (例 : T2) : 5mg
Pack9	2(a)(2)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter \geq 9 mm and \leq 17 mm (e.g. T5): 5 mg	通常寿命の tri-band phosphor で、管径が 9mm 以上、17mm 以下のもの (例 : T5) : 5mg
Pack9	2(a)(3)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 17 mm and \leq 28 mm (e.g. T8): 5 mg	通常寿命の tri-band phosphor で、管径が 17mm を超え、28mm 以下のもの (例 : T8) : 5mg
Pack9	2(a)(4)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 28 mm (e.g. T12): 5 mg	通常寿命の tri-band phosphor で、管径が 28mm を超えるもの (例 : T12) : 5mg
Pack9	2(a)(5)	Tri-band phosphor with long lifetime (\geq 25 000 h): 8 mg	長寿命 (25,000 時間以上) の tri-band phosphor : 8mg
	2(b)	Mercury in other fluorescent lamps not exceeding (per lamp):	その他の蛍光ランプ中の、以下の値を超えない水銀 (1 ランプにつき)
	2(b)(1)	Linear halophosphate lamps with tube \geq 28 mm (e.g. T10 and T12): 10 mg	直管型 halophosphate ランプで、管径が 28mm を超えるもの (例 : T10 および T12) : 10mg
	2(b)(2)	Non-linear halophosphate lamps (all diameters): 15 mg	非直管型 halophosphate ランプ (すべての管径のもの) : 15mg
Pack9	2(b)(3)	Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter > 17 mm (e.g. T9)	非直管型 tri-band phosphor ランプで、管径が 17mm を超えるもの (例 : T9)
Pack9	2(b)(4)	Lamps for other general lighting and special purposes (e.g. induction lamps)	その他一般照明用途で、特殊用途のランプ (例 : 誘導ランプ)
	3	Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for special purposes not exceeding (per lamp):	特殊用途の冷陰極蛍光ランプと外部電極蛍光ランプ (CCFL および EEFL) 中の以下の値を超えない水銀 (1 ランプにつき)

Pack9	3(a)	Short length (≤ 500 mm)	短型 (500mm 以下)
Pack9	3(b)	Medium length (> 500 mm and ≤ 1500 mm)	中型 (500mm を超え 1,500mm 以下)
Pack9	3(c)	Long length (> 1500 mm)	長型 (1,500mm 超)
Pack9	4(a)	Mercury in other low pressure discharge lamps (per lamp)	その他低圧放電ランプ中に含まれる水銀 (1 ランプにつき)
	4(b)	Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index $R_a > 60$:	改良された演色評価数 $R_a > 60$ の、一般照明用途の高圧ナトリウム (蒸気) ランプ中の、以下を超えない水銀 (1 バーナーにつき)
Pack9	4(b)-I	$P \leq 155$ W	$P \leq 155$ W
Pack9	4(b)-II	155 W $< P \leq 405$ W	155 W $< P \leq 405$ W
Pack9	4(b)-III	$P > 405$ W	$P > 405$ W
	4(c)	Mercury in other High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner):	一般照明用途のその他高圧ナトリウム (蒸気) ランプ中の、以下を超えない水銀 (1 バーナーにつき)
Pack9	4(c)-I	$P \leq 155$ W	$P \leq 155$ W
Pack9	4(c)-II	155 W $< P \leq 405$ W	155 W $< P \leq 405$ W
Pack9	4(c)-III	$P > 405$ W	$P > 405$ W
	4(d)	Mercury in High Pressure Mercury (vapour) lamps (HPMV)	高圧水銀 (蒸気) ランプ (HPMV) 中に含まれる水銀
Pack9	4(e)	Mercury in metal halide lamps (MH)	メタルハライドランプ (MH) 中に含まれる水銀
Pack9	4(f)	Mercury in other discharge lamps for special purposes not specifically mentioned in this Annex	本附属書で特に定められていない特殊用途のその他放電ランプ中に含まれる水銀
2018.12.31	4(g)	Mercury in hand crafted luminous discharge tubes used for signs, decorative or architectural and specialist lighting and light-artwork, where the mercury content shall be limited as follows: (a) 20 mg per electrode pair + 0,3 mg per tube length in cm, but not more than 80 mg, for outdoor applications and indoor applications exposed to temperatures below 20 °C; (b) 15 mg per electrode pair + 0,24 mg per tube length in cm, but not more than 80 mg, for all other indoor applications.	標識、装飾用または建築用に使される手工芸的発光放電管、専門家による照明器具及び光工芸品中の水銀の水銀含有量は次の通り制限されなければならない: (a) 20°C未満の温度にさらされる屋外用途及び屋内用途において、電極1対当たり 20mg に管長 1 cmあたり 0.3 mg を加算、ただし 80 mg を超えない; (b) その他全ての屋内用途において電極1対当たり 15mg に管長 1 cmあたり 0.24 mg を加算、但し 80 mg を超えない
	5(a)	Lead in glass of cathode ray tubes	陰極線管のガラス中に含まれる鉛
Pack9	5(b)	Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0,2 % by weight	重量比 0.2% を超えない蛍光管ガラス中に含まれる鉛
Pack9	6(a)	Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanized steel containing up to 0,35 % lead by weight	機械加工用途の鋼鉄および亜鉛めっき鋼中の、合金成分として重量比 0.35% まで含まれる鉛
Pack9	6(b)	Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight	アルミニウムに合金成分として重量比 0.4% まで含まれる鉛
Pack9	6(c)	Copper alloy containing up to 4 % lead	合金成分として鉛を重量比 4% まで含む

		by weight	銅合金
Pack9	7(a)	Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead)	高融点はんだに含まれる鉛(すなわち鉛含有率が 85%を超える錫/鉛はんだ合金)
	7(b)	Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signalling, transmission, and network management for telecommunications	サーバ、ストレージおよびストレージ・アレイ・システム、スイッチ/信号/電送用ネットワーク・インフラストラクチャ装置および通信管理ネットワークに使われるはんだに含まれる鉛
Pack9	7(c)-I	Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezoelectronic devices, or in a glass or ceramic matrix compound	キャパシタ中の誘電セラミックを除く、ガラスまたはセラミック中に鉛を含有する電気電子部品(例: ピエゾエレクトリックデバイス、ガラスまたはセラミックマトリックス複合材料中)
Pack9	7(c)-II	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of 125 V AC or 250 V DC or higher	定格電圧 AC 125V または DC 250V 以上用のキャパシタ中の誘電セラミック中の鉛
	7(c)-III	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC	定格電圧 AC 125V または DC 250V 未満用のキャパシタ中の誘電セラミック中の鉛
Pack9	7(c)-IV	Lead in PZT based dielectric ceramic materials for capacitors being part of integrated circuits or discrete semiconductors	集積回路またはディスクリット半導体の部品であるコンデンサのための PZT 系誘電体セラミック材料中の鉛
	8(a)	Cadmium and its compounds in one shot pellet type thermal cut-offs	ワンショットペレット型のサーマルカットオフに含まれるカドミウムおよびその化合物
Pack9	8(b)	Cadmium and its compounds in electrical contacts	電気接点中のカドミウムおよびその化合物
Pack9	9	Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0,75 % by weight in the cooling solution	冷却剤中で重量比 0.75%未満の、吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防錆用としての6価クロム
Pack7	9(b)	Lead in bearing shells and bushes for refrigerant-containing compressors for heating, ventilation, air conditioning and refrigeration (HVACR) applications	暖房/換気/空調/冷凍 (HVACR) 用途の冷媒含有コンプレッサの軸受シェルと軸受ブッシュに含まれる鉛
	11(a)	Lead used in C-press compliant pin connector systems	C-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタ・システムに使用される鉛
	11(b)	Lead used in other than C-press compliant pin connector systems	C-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタ・システム以外に使用される鉛
	12	Lead as a coating material for the thermal conduction module C-ring	熱伝導モジュール C-リングのコーティング材に使われる鉛
Pack7	13(a)	Lead in white glasses used for optical applications	光学的応用に用いられる白ガラス中の鉛
Pack7	13(b)	Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for reflectance standards	フィルターガラスおよび反射率標準に用いられるガラス中の鉛
	14	Lead in solders consisting of more than two elements for the connection between the pins and the package of microprocessors with a lead content of	マイクロプロセッサのピンとパッケージの結合用で 2 種以上の成分を含有するはんだ中の鉛で、鉛含有量が 90%以上 95%以下のもの

		more than 80 % and less than 85 % by weight	
Pack9	15	Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages	IC フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリアの電気結合用に使われるはんだ中の鉛
	16	Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes	ケイ酸塩 (silicate) がコーティングされたバルブを有する直線型白熱電球の鉛
	17	Lead halide as radiant agent in high intensity discharge (HID) lamps used for professional reprography applications	プロフェッショナル向け複写用途に使用される高輝度放電 (HID ランプ中の放射媒体としてのハロゲン化合物
	18(a)	Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of discharge lamps when used as speciality lamps for diazoprinting reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS ((Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7 :Pb)	SMS ((Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7 :Pb)などの蛍光体を含むジアゾ印刷複写、リソグラフィ、捕虫器、光化学、硬化処理用の特殊ランプとして使用される放電ランプの蛍光粉末中の賦活剤としての鉛 (重量比 1%以下)
Pack9	18(b)	Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi 2 O 5 :Pb)	BSP(BaSi2O5:Pb) などの蛍光体を含む日焼け用ランプとして使用される放電ランプの蛍光体粉の賦活剤としての鉛(重量比 1%以下)
	19	Lead with PbBiSn-Hg and PbInSn-Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn-Hg as auxiliary amalgam in very compact energy saving lamps (ESL)	非常にコンパクトな省エネルギーランプ (ESL) の中にある主要合金としての特定化学組成の中の鉛・ビズマス・スズ 水銀・鉛・インジウム・スズ 水銀または補助合金としての鉛・スズ 水銀を伴う鉛
	20	Lead oxide in glass used for bonding front and rear substrates of flat fluorescent lamps used for Liquid Crystal Displays (LCDs)	液晶ディスプレイ (LCD) に使用されるフラット蛍光ランプの接着前面部と後部基板に使用されるガラスの中の酸化鉛
Pack9	21	Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on glasses, such as borosilicate and soda lime glasses	ホウケイ酸ソーダ石灰ガラスのエナメル加工に用いられる印刷用インクの鉛およびカドミウム
	23	Lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0,65 mm and less	ピッチが0.65mm以下のコネクタ以外の、微細ピッチコンポーネントの仕上げに用いられる鉛
Pack9	24	Lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors	セラミック多層コンデンサの円形で平面配置の機械加工のスルーホールのはんだ付けのためのはんだ中の鉛
	25	Lead oxide in surface conduction electron emitter displays (SED) used in structural elements, notably in the seal frit and frit ring	構造要素、特にシールフリットおよびフリットリングに用いられる表面伝導型電子放出素子を用いたディスプレイ (SED) に含まれる酸化鉛
	26	Lead oxide in the glass envelope of black light blue lamps	ブラックライトブルーランプのガラス管体中の酸化鉛
	27	Lead alloys as solder for transducers used in high-powered (designated to operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above) loudspeakers	音響出力レベル 125 dB SPL 以上で数時間使用に設計された高出力拡声器の用いられるトランスデューサー用のはんだ中の鉛合金
Pack9	29	Lead bound in crystal glass as defined in Annex I (Categories 1, 2, 3 and 4) of	理事会指令 69/493/EEC の附属書 I (カテゴリー 1、2、3 および 4) 定義されたク

		Council Directive 69/493/EEC (* 1)	リスタルガラス中の酸化鉛 (Lead bound)
	30	Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB (A) and more	100dB 以上の音声出力のハイパワーラウドスピーカーに使用されるトランスデューサー中のボイスコイルに直接電氣的に設置されるコンデューサーをジョイントするための電氣的および機械的はんだとしてのカドミウム合金
	31	Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g. are used for liquid crystal displays, design or industrial lighting)	水銀フリーの直管光灯中の溶接材に含まれる鉛 (液晶ディスプレイや設計または産業用照明に使用されている。)
Pack9	32	Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton laser tubes	アルゴンおよびクリプトン管のウィンドウアッセンブリを形成するシールフリット中の酸化鉛
	33	Lead in solders for the soldering of thin copper wires of 100 µm diameter and less in power transformers	パワー変圧器の 100µm 以下の細い銅線のはんだ付用はんだ中の鉛
Pack9	34	Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements	サーメットベースのトリマーポテンシオメーター中の鉛サーメットを主とするトリマー電位差計構成要素
	36	Mercury used as a cathode sputtering inhibitor in DC plasma displays with a content up to 30 mg per display	DC プラズマディスプレイの陰極スパッタリング抑制剤として用いられる、1ディスプレイにつき 30mg 未満の水銀
Pack9	37	Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate glass body	ほう酸亜鉛ガラス体ベースの高電圧ダイオードのめっき層中の鉛
	38	Cadmium and cadmium oxide in thick film paste used on aluminium bonded beryllium oxide	アルミニウム結合ベリリウム酸化物に使用される厚膜ペースト中のカドミウムおよびカドミウム酸化物
Pack10	39	Cadmium in colour converting II-VI LEDs (< 10 µg Cd per mm ² of light-emitting area) for use in solid state illumination or display systems	個体状態照明あるいはディスプレイ・システムで使用するための色変換 II-VI LED 中のカドミウム (発光面積の平方ミリメートルあたり 10µg 未満のカドミウム)
	40	Cadmium in photoresisters for analogue optocouplers applied in professional audio equipment	プロフェッショナル用オーディオ機器用アナログ・フォトカプラのためのフォトレジスタ中のカドミウム
2018.12.31	41	Lead in solders and termination finishes of electrical and electronic components and finishes of printed circuit boards used in ignition modules and other electrical and electronic engine control systems, which for technical reasons must be mounted directly on or in the crankcase or cylinder of hand-held combustion engines (classes SH:1, SH:2, SH:3 of Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council)	電気電子機器部品のはんだ及び端子処理部分、並びに点火用モジュール及びその他の電気電子的エンジン制御システムに用いるプリント配線基板の仕上げ処理部分中の技術的理由から携帯式の燃焼機関 (欧州議会及び理事会指令 97/68/EC のクラス SH:1, SH:2, SH:3) のクランクケースまたはシリンダー上に直接、またはそれらの内部に取り付けられねばならないものに含まれる鉛